

## 半導体デバイスのトレンドに基づく半導体 製造装置に求められる開発アプローチ

半導体デバイスは世代の進行とともに微細化・高集積化が進み、3次元化などによりデバイス構造は一層複雑になっています。その結果、表面積が増大し、成膜装置には高い被覆性や膜厚均一性といった厳しい要求が課せられます。

本セミナーでは、世代進行が成膜プロセスに与える影響を整理するとともに、次世代成膜装置に求められる開発アプローチについて解説します。

■ 日時：令和8年 6/9 (火)

13:40 - 14:40

■ 開催方法：

先進地視察 (Part 1) の現地セミナー

(注意：WEBでの配信はありません)

■ 募集人員：先着25名

■ 対象者：先進地視察参加者

講師

■ 申込み方法：

別の先進地視察開催案内にてお申込ください。

- ・デジタル技術基盤分野研究会への新規入会ご希望の方は、「裏面：入会申込書」  
または、先進地視察申込用紙で申込みください。(FAX、Eメール、電話でも可)



株式会社  
KOKUSAI ELECTRIC  
先行要素技術開発部長  
佐々木 隆史 氏

## 講師

佐々木 隆史 氏  
(ささき たかふみ)

## プロフィール

2005年：株式会社日立国際電気(現KOKUSAI ELECTRIC)入社

2023年：モジュール開発部/部長

2026年現在：先行要素技術開発部/部長

北海道釧路市で生まれ育つ。大学時代は半導体製造装置内のガス流れ・熱移動の研究に従事し、可視化実験や熱評価を模擬する熱流体解析モデルを開発した。博士課程(工学)修了後、当社に入社。化学反応をともなうガス流れ解析モデルの構築を行ない装置開発をサポート。

Racing drone、車/楽曲のカスタム、アナログ的な無駄を好む三女の父。

## デジタル技術基盤分野研究会入会申込書

(入会希望の方は、下記に記入ください。)

デジタル技術分野関連産業にご興味や、新たに事業参入・利活用への意欲のある企業・団体等に所属される方が対象です。

必要事項をご記入の上、e-mail 又は FAX にてお申込みください。

(セミナーの開催案内や、ロボットに関する情報提供をさせていただきます。登録人数に制限はありません。)

研究会加入申込書(加入希望者の方のお名前等をご記入ください)

※ご記入頂いた事項は、当該事業の運営の為のみに使用し、他の目的には使用しません。

企業名・団体名			
所在地	(〒 )		
連絡担当者		FAX	
TEL		E-mail	
会員希望者名			
E-mail		FAX	
所属部署		職位・職名	
会員希望者名			
E-mail		FAX	
所属部署		職位・職名	